



ASSEMBLAGE DE SEMICONDUCTEURS

Découvrez nos capacités

Le C2MI offre une vaste gamme d'équipement permettant de réaliser l'assemblage du semi-conducteur (advanced packaging) sur un substrat pour en faire un produit fini prêt pour l'assemblage à la carte.

Les installations du C2MI permettent l'amincissement et le découpage de tranches de 200mm et 300mm, l'assemblage par puce renversée et brasure ou collage et microcâblage de composants avec une précision de positionnement pouvant atteindre $1\ \mu\text{m}$ pour tous types de circuits intégrés ou optoélectroniques.

Nos procédés

- Découpage de tranches
- Choix de puces (Picking)
- Positionnement de puces et de composants
- Adhésif et pâte thermique
- Microcâblage
- Attachement de capot
- Soudure de billes
- Marquage





Le Centre

Le C2MI est le plus important centre de recherche et développement en microélectronique au Canada. Offrant des équipements à la fine-pointe de la technologie principalement dédiés à l'encapsulation avancée de puces électroniques et aux microsystèmes électromécaniques (MEMS), le Centre regroupe plus de 250 scientifiques en recherche et développement (R&D).

« La collaboration et la synergie de nos membres favorisent la commercialisation accélérée de prototypes avancés. »



Centre de Collaboration
MiQro Innovation

45 boulevard de l'Aéroport
Bromont, QC, Canada, J2L 1S8
450-534-8000
www.c2mi.ca

